

## **Amateur Research**

# Improve the Thermal Stability of the CrO2 Films

**Wuhan University** 

School of Physics and Technology, 15 Hongyi Class

报告人:陈亦林





需要解决 的问题



解决方案



初步成果和 需要改进的地方

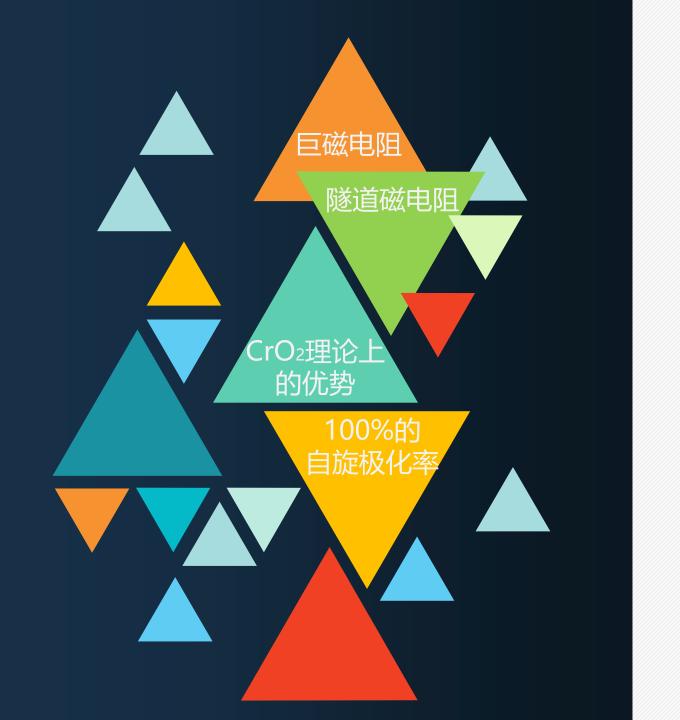


参考文献



鸣谢

## 目录 / CONTENTS





Part 1

# 研究背景

Background



需要解决的问题

解决方案

初步成果和一些问题

参考文献

鸣谢

随着科学技术的迅速发展,对各种电子设备的性能要求也不断提高,为了适应高密度信息存储,快速读写和自动化传感的需要,磁电阻的研究不断地发展起来。

#### 磁电阻(MR)效应

在磁场作用下,某些铁磁体电阻值发生变化的现象

#### 庞磁电阻(CMR)

Colossal Magneto Resistance

#### 巨磁电阻(GMR)

Giant Magneto Resistance

#### 隧道磁电阻(TMR)

Tunnel Magneto Resistance



需要解决的问题

解决方案

初步成果和一些问题

参考文献

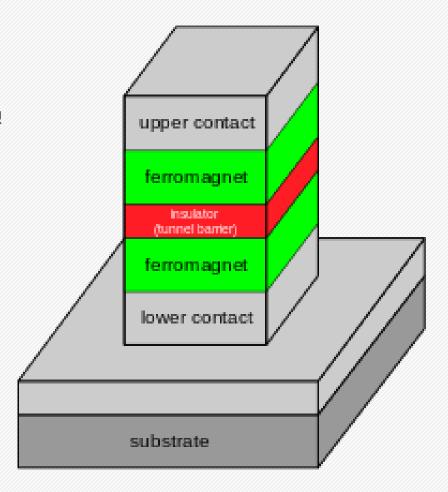
鸣谢

### TMR效应原理

TMR效应是一种与自旋极化输运过程相关的现象。以发现该

TJ)为例赖 效应的引 V(x)说明一丁 之下表现 具有 出铁磁性 当一 的"三明 治结构 量子力学 根据经典 中量子院 逐越大, 电子隧穿势垒示意图 表现出来

TMR效应通俗一点说:铁磁层的磁化方向可以在外磁场的控制下被独立的切换。如果**极化方向平行**,那么电子隧穿过绝缘层的可能性会更大,其宏观表现为**电阻小**;如果**极化方向反平 行**,那么电子隧穿过绝缘层的可能性较小,其宏观表现是**电阻 极大**。因此,这种结可以在两种电阻状态中切换,即高阻态和低阻态。





需要解决的问题

解决方案

初步成果 和一些问题

参考文献

鸣谢

## 隧道磁电阻值

$$TMR = 2P_1P_3/(1 - P_1P_3)$$

其中, $P_1$ 和 $P_3$ 分别为第一,第三铁磁层的自旋极化率 并且可以看出,这两层**铁磁层的自旋极化率越高,隧道磁电阻越大**。

而寻求**磁电阻值高,饱和磁场小,磁场灵敏度高**的磁阻材料是当前研究工作的重点 因此铁磁层最理想的材料是半金属,因为其自旋极化率理论上达到100%。 而其中**CrO**2就是是一种结构简单的半金属。



## 需要解决的一些问题

研究背景

需要解决的问题:

解决方案

初步成果和一些问题

参考文献

鸣谢

#### 非磁性层上 生长二氧化铬 非常困难

"三明治型" MR,两边是二氧化铬,中间是非磁性层。晶格匹配的非磁性层很少。

#### 膜很薄时 薄膜厚度很难精准控制

很难控制很薄的薄膜厚度。



#### 热稳定性不高

◆CrO₂薄膜只能在390-410℃通过化学气相沉积法(CVD)制备(以CrO₃为先导物,TiO₂为基底),而且很容易有杂相Cr₂O₃。因此不仅导致制备困难,并且常温应用条件下,表面缓慢分解,形成绝缘的反铁磁的Cr₂O₃层,导致其很难运用到器件中





Part 3

## 解决方案 Solution



需要解决的问题

#### 解决方案

初步成果 和一些问题

参考文献

鸣谢

#### 通过掺杂

#### Ti元素的优点

#### 寻找Ti源

#### 选择TiF4的优点

希望通过掺杂其他 元素来提高二氧化 铬的热稳定性 1.TiO<sub>2</sub>是一种非常稳定的单晶,与CrO<sub>2</sub>的晶格结构具有很高的匹配度。2,理论可以通过元素替代提高CrO<sub>2</sub>稳定性。

1.熔点要求:要尽量和纯CrO2的制备温度范围相近2.尽量减少杂相Cr2O3的生成

1.熔点符合要求 2.实验结果看出 热稳定性提高, 制备温度范围变 宽

## 〉 解决方案

研究背景

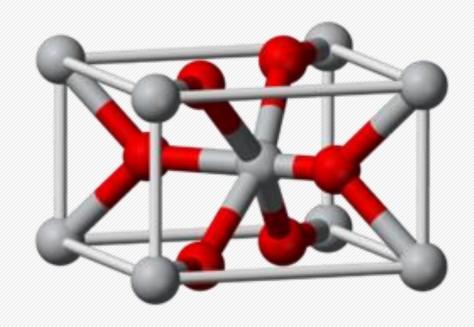
需要解决的问题

#### 解决方案

初步成果 和一些问题

参考文献

鸣谢



TiO2, CrO2晶格结构



需要解决的问题

#### 解决方案

初步成果和一些问题

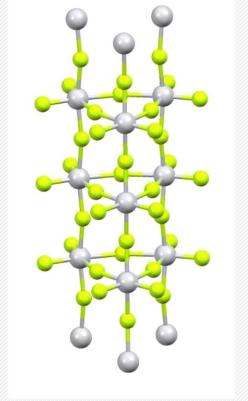
参考文献

鸣谢

## 四氟化钛TiF4

TiF4熔点377°C(CVD温度390°C以上)

其他的无机钛源的熔点一般很高,常远高于制备条件而有机钛源虽然熔点比较低,但是很容易被三氧化铬(先导物"铬源")氧化而覆盖在三氧化铬的表面,阻断反应的继续进行。



"钛源" TiF4晶格结构

TiF4 CrO<sub>3</sub>



通入O2 100ml/min - (流速可调,并且对

CrO2生长速度和最终

能否形成薄膜影响很大)

## > 具体流程

化学气相沉积法(CVD) (Chemical Vapor Deposition)



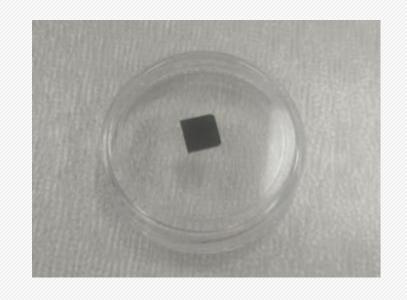
TiO2基底(110/100) 可以先用HF处理表面,更容易 形成薄膜



根据需求设置反应时间,所示情况下,一般30min,掺杂的CrO2薄膜可以生长100nm厚



## 掺杂后的CrO2薄膜外观





光滑,表面有金属光泽的黑色镜面





Part 4

## 初步成果 和一些问题 Conclusion&Problem



需要解决的问题

解决方案

初步成果 和一些问题

参考文献

鸣谢

## 不同制备温度下样品的X-ray diffraction (XRD)图

1.相对于纯CrO₂薄膜的制备温度范围390-410℃) 掺杂了Ti的CrO₂薄膜温度 范围变广,并且更加耐受 高温热稳定性提高 2. 杂相Cr₂O₃出现的温度 显著提高,也是样品热稳 定性提高的表现

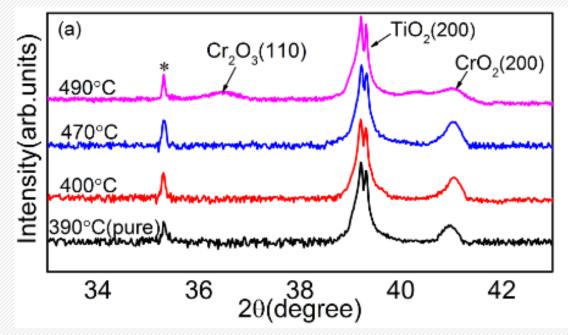


图1 不同实验温度条件下,掺杂后的 CrO2薄膜的XRD图

(以在100方向的TiO₂基底上生长为例, 110方向的温度范围大约为390-500°C)



需要解决的问题

解决方案

初步成果 和一些问题

参考文献

鸣谢

### 样品不同温度退火处理后的XRD图

从右图可以看出,退火温度至510℃仍无杂相出现,退火温度为520℃时,杂相 火温度为520℃时,杂相 Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>慢慢出现。当退火温 度达到530℃时,CrO<sub>2</sub>完全 转化为杂相Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>。

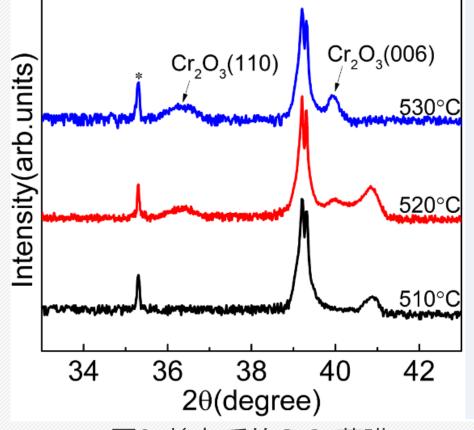


图2 掺杂后的CrO2薄膜 在不同温度下退火处理后,样品的XRD图



需要解决的问题

解决方案

初步成果 和一些问题

参考文献

鸣谢

1.选择TiF4为钛源,通过化学气相沉积法成功地制备了掺杂Ti的CrO2薄膜。

2.从不同温度下制备和退火的XRD图可以看出,相较于纯CrOz薄膜,掺杂了Ti的CrOz薄膜热稳定性提高,更加耐受高温,制备的温度范围变广,因此初步认为达到了提高CrOz薄膜热稳定性的目的。



需要解决的问题

解决方案

初步成果 和一些问题

参考文献

鸣谢

亟待解决的一些问题

- 1.掺杂后的薄膜的居里点(铁磁顺磁的相变点的温度)降低,虽然在低掺 杂浓度下仍高于室温。
- 2.单轴的各向异性降低。



需要解决的问题

解决方案

初步成果和一些问题

参考文献

鸣谢

[1]Q Zhao, JJ Yuan. Preparation and magnetoresistance of thin CrO 2 films [J]. Journal of Magnetism & Magnetic Materials, 2008, (3):2356-2358.

[2] K Schwarz. CrO2 predicted as a half-metallic ferromagnet [J]. Journal of Physics F Metal Physics, 2000, (16).

[3] RS Keizer, ST Goennenwein. A spin triplet supercurrent through the half-metallic ferromagnet CrO2 [J]. Nature, 2010, (2).



需要解决的问题

解决方案

初步成果 和一些问题

参考文献

鸣谢

感谢熊锐教授和张振华学长一直以来的知道指导和支持!

# Thanks